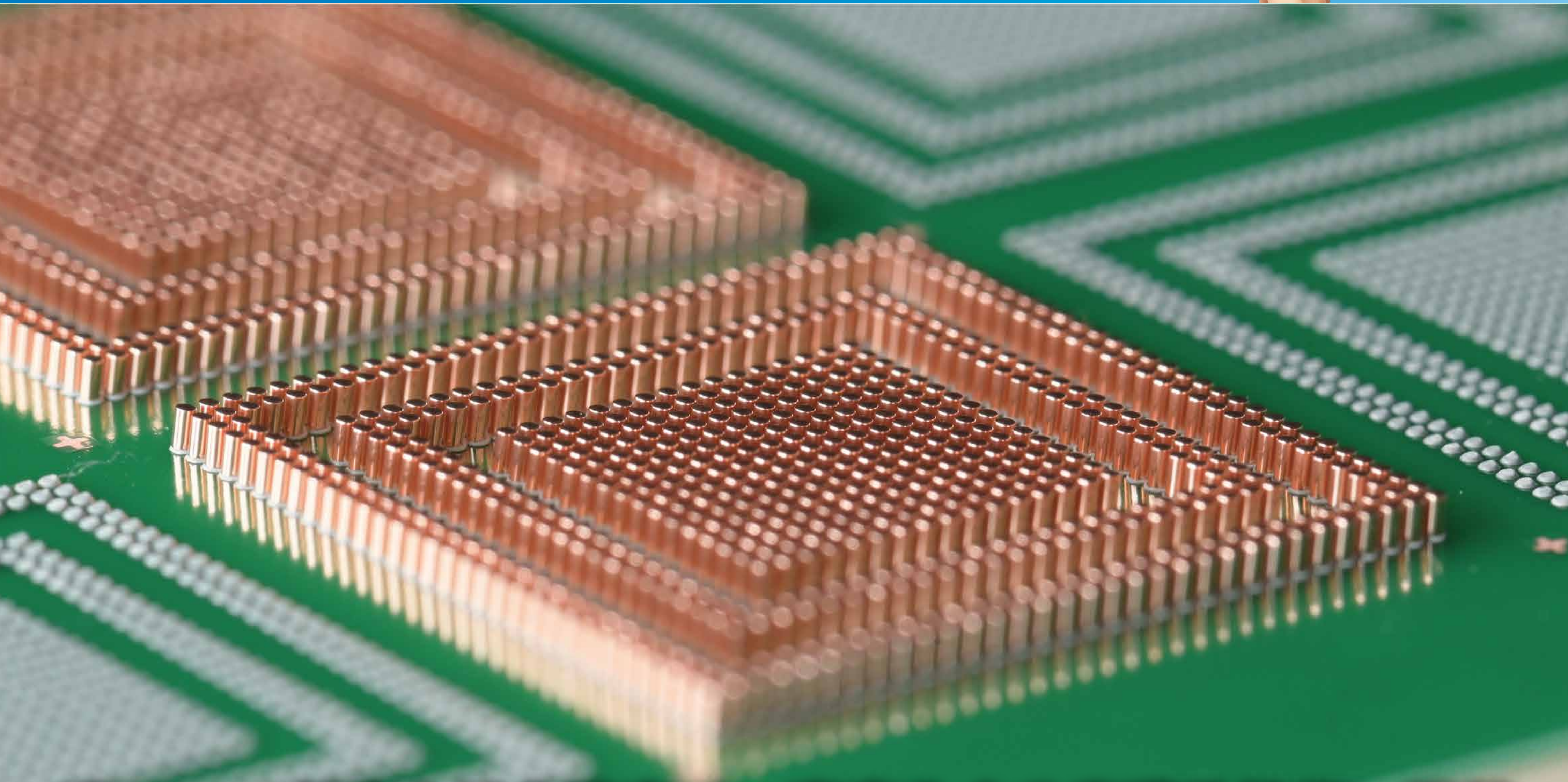


# Cu ピラー搭載装置

Cu Pillar Mounting Machine



**狭ピッチ対応と接合強度で、高度化する半導体技術に貢献**

Contributing to the sophisticated packaging technology with fine-pitch and secured bonding

**FOWLP や POP 構造などの 3D パッケージに必要となる Cu ポストのプロセス技術  
カイジョーが高精度のマウントソリューションを提供いたします**

Cu post process technology required for 3D packaging such as FOWLP and POP  
**KAIJO provides high-precision mounting solutions**

## ◆主な仕様

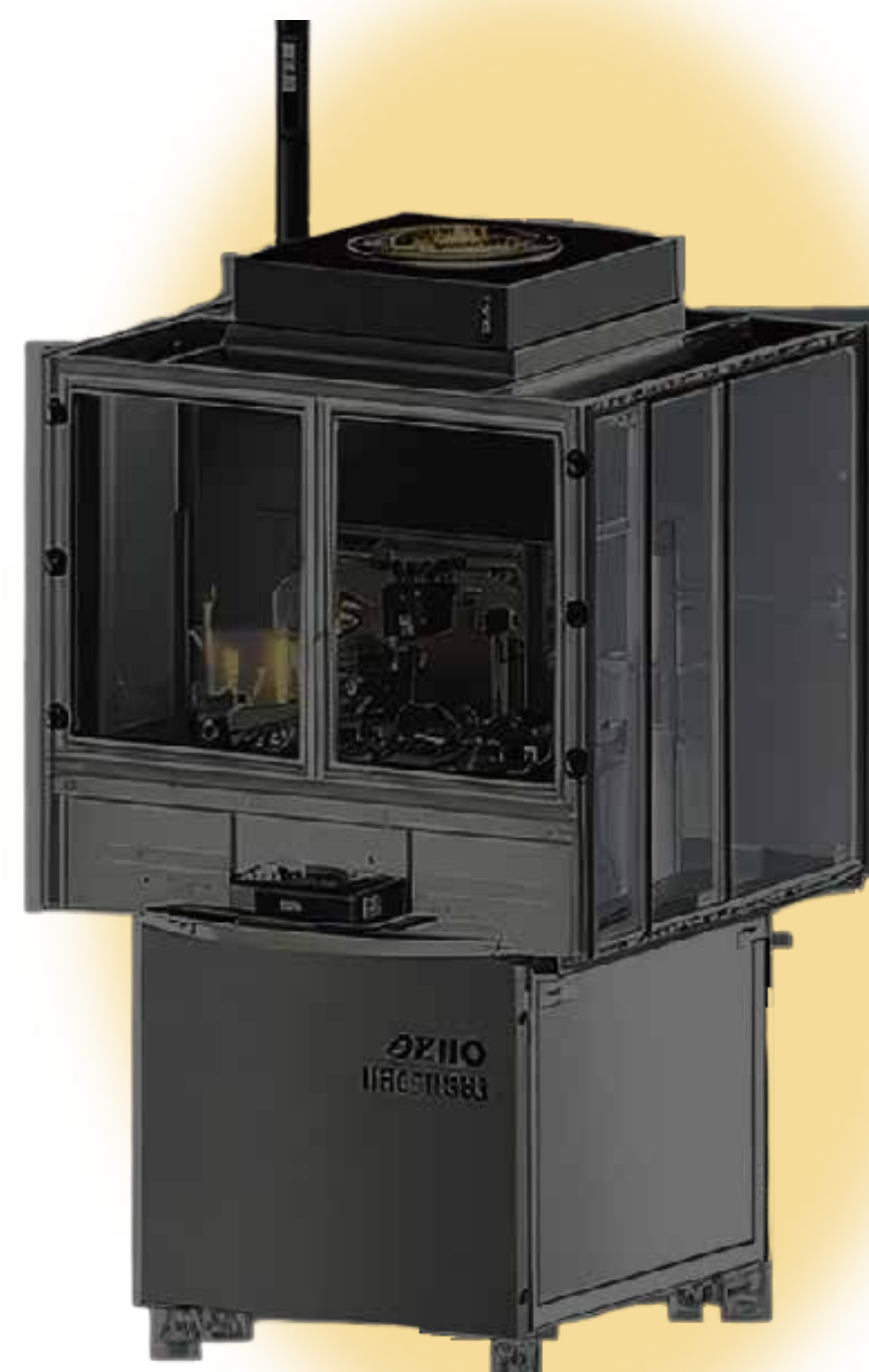
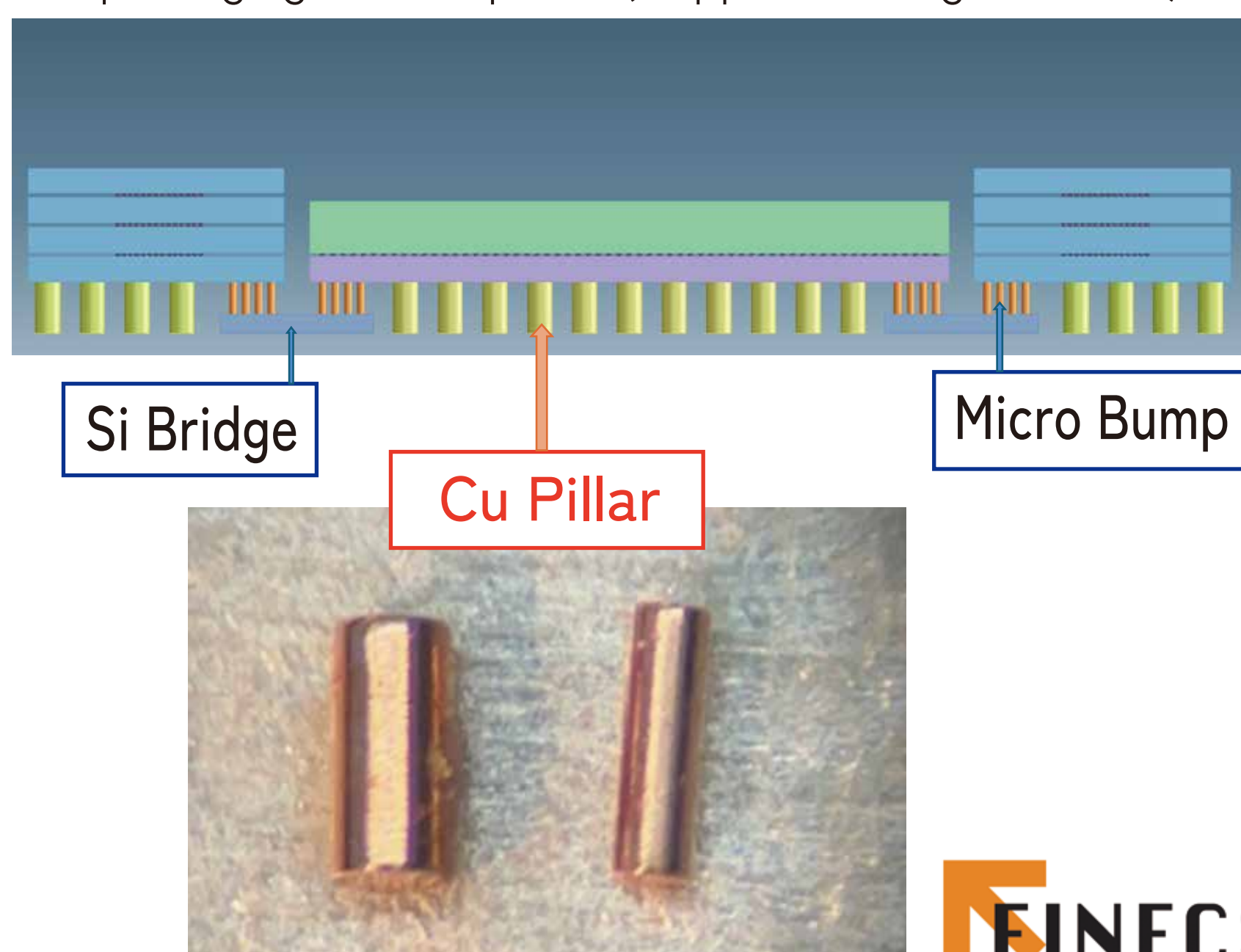
Specifications

項目 Item	仕様 Spec.
実装範囲 Mounting area	X : 44mm Y : 80mm
ピラーサイズ Pillar size	Φ : 0.3~0.5mm H : 0.6~1.0mm
プロセス Process	1 shot
搭載精度 Mount accuracy	XY : $R \leq 32 \mu\text{m}$ Tilt : $R \leq 5^\circ$
サイクルタイム Cycle time	0.2 Sec

ピラーサイズφ0.3mm 以下は  
お問い合わせください。

For pillar sizes below φ0.3mm,  
please contact us for more information.

Cu ピラー (銅製の接合端子) による 3D 実装  
3D packaging with Cu pillars (Copper bonding terminals)



2025 年 発売予定  
To be released 2025

**FINECS**